

## 超低热阻导热硅脂

TG300-LR是一款具有超低热阻系数的导热硅脂。该产品不含有金属导热填料，耐热性、长效性、可靠性佳，同时其极低的BLT厚度可以有效减少散热器及发热源之间的接触热阻，适用于需要最小压缩厚度、恒定压力和高界面热管理能力需求的应用场合。



### 特性和优点

- 导热系数3.0W/(m·K)
- 不含金属填料颗粒，高绝缘
- 低游离度
- 长效性、可靠性佳
- 接触面湿润性佳，有效降低界面热阻

### 典型应用

- IT-笔记本、服务器、电脑、存储模组
- 网络通讯装备—无线模块、路由器
- 消费类电子—游戏系统、便携设备
- 工业工控设备
- 电源
- 高功率LED照明

### 典型属性

属性	典型值	测试方法
颜色	白色	目视
密度(g/cc)	3.2	ASTM D792
BLT(μm)	5	千分尺
挥发份(%)	≤0.5	@125°C/48h
粘度(cP)	340000	DV2T-T96-12RPM
锥入度(0.1mm@25°C)	326	GB/T269
耐温范围(°C)	-40~150	/
保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥5.0	ASTM D149
体积电阻率(Ω·cm)	10 <sup>10</sup>	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	3.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in <sup>2</sup> /W@50psi,80°C)	≤0.006	ASTM D5470